

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2023年度业绩说明会)

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月09日 15:00-17:00
地点	公司通过“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先生，财务总监孙剑先生，保荐代表人柳志强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>上海润欣科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2024年5月9日（星期四）下午15:00-17:00通过“价值在线”举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1：公司在2023年度的营业收入轻微增长，但净利润下降了34.15%，主要原因是什么？</p> <p>答：2023年受到地缘政治冲突和下游需求及宏观经济疲软的影响，全球半导体市场仍处于行业下行周期，终端客户进入去库存</p>

化周期，市场产品价格竞争加剧。2023年公司归属于母公司股东的净利润3,563.22万元，比2022年度下降34.15%；2023年度利润下降的主要原因是：（1）2023年度毛利率较2022年度下降了0.9个百分点，毛利额减少1,332.88万元；（2）资产减值损失（主要是计提存货跌价准备）较2022年度增加2,292.48万元。

Q2：公司在AIOT领域的研发投入和未来规划是什么？

答：在AIOT领域公司规划增加传感器芯片、分立器件、存储芯片等产品线，增加晶圆代工分销和模数混合芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括EDA综合工具、晶圆CP测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应，提升公司主营业务的核心竞争力。

Q3：在PZT压电薄膜工艺研究及平台建设项目上的投资回报预期是怎样的？

答：项目支撑PZT压电薄膜沉积共性关键技术，包括低应力压电堆积薄膜沉积工艺、高机电耦合MEMS工艺、多层压电薄膜沉积，已参与投资建设国内首个8英寸PZT薄膜化MEMS生长与加工平台，为传感器厂商提供加工与工艺测试服务。项目预期2025年量产。

Q4：请问如何应对当前半导体行业的下行周期，并预计何时能够恢复增长？

答：针对半导体行业的下行周期，公司规划在传感器特色工艺、低功耗无线芯片等领域追加研发和产业投资，预计2024年度恢复业务增长。

Q5：是否有计划进一步扩大在汽车电子领域的市场份额？

答：公司的汽车电子产品在每辆新能源汽车里超过600颗，客

户包括国内主力的整车制造企业和汽车电子零部件厂商。后续将新增氮化镓、IGBT、碳化硅等新的品类，继续扩大在汽车电子领域的市场份额。

Q6: 目前在MEMS阵列采集及声控定向扬声器项目上的技术优势和市场潜力如何?

答: MEMS阵列扬声器有微尺寸、低功耗、高频补偿和定向性优点,产品可广泛应用于助听、智能家居控制、眼镜近场通讯、汽车头枕、人形机器人听觉系统,具有较大的市场潜力,是公司新的业务增长点。

Q7: 请问公司在感存算一体化芯片技术上的研发进展如何?

答: 为增强公司AIOT芯片业务的边缘计算能力,提升公司在智能声学 and 可穿戴传感领域的关键技术水平,公司参股国家智能传感器创新中心暨上海芯物科技有限公司,启动感存算一体化产业生态建设,双方合作研发的PZT薄膜化MEMS生产工艺平台、PMUT感存算一体化芯片项目,在智能声学、智能家居、生物检测等领域有良好的市场预期。

Q8: 公司的主要供应商的合作关系稳定性如何,是否有备选供应链计划?

答: 公司的主要供应商包括了高通、思佳讯、安世半导体、AVX/京瓷、恒玄科技、瑞声科技等在全球具有重要影响力的IC设计公司。是公司多年的业务合作伙伴,上游优质的IC设计资源使得公司在产品竞争力、新技术学习能力等方面具有优势,对于公司的持续发展起到方向性作用。

Q9: 请介绍下在微能量采集和无线IOT网络芯片方面的研发成果?

答：公司在微能量采集和无线IOT芯片方面的研发成果包括：芯片能在微型设计里实现超低功耗，收集周围环境存在的电磁、热能、光能、动能，实现免电池通讯连接。芯片还设计了多种I/O接口和工具，包括AT命令软件包和软件开发工具包（SDK），适配各种不同类型的传感器和场景应用。目前产品已应用于阿里IOT新零售、美的集团、米+生态链、FreeBox遥控器等重要客户的产品中，公司还规划拓展生物医疗、Fingmy防丢和智慧农业等产品应用。

Q10：目前是否有计划进行国际市场扩张，特别是在哪些地区？

答：根据客户需求，公司在港台、新加坡、东南亚进行业务扩展，并寻求欧美市场的业务扩展。

Q11：在AI Chatbot数字聊天机器人项目上的商业化计划和目标市场是什么？

答：公司AI Chatbot数字聊天机器人的目标市场是养老服务行业。公司规划和主要供应商合作，采用低功耗AI芯片实施机器学习、人体感知功能，在智能客厅场景下，扩充AI语音交互与数字聊天机器人功能。产品通过升级音视频的机顶盒/智能音箱，为老年人提供个性化的情感交流和提醒服务。目前已在海外市场找到目标客户，和国内的数家养老机构达成合作意向，计划在两年时间内训练AI Chatbot机器人并商用10000台。

Q12：公司在研发人员和研发投入方面的变化是否会对公司的创新能力产生影响？

答：公司的研发投入较上年度并没有变化。2023年度研发支出合计3,923.16万元，其中费用化研发支出3,412.80万元；符合资本化条件的研发项目产生的资本化研发支出510.36万元，研发支出总额较2022年度减少541.83万元，主要原因是2023年度经审计合并利润

	<p>表中归属于上市公司股东的剔除本次及其他激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的净利润无法满足公司层面关于第三个解除限售期业绩目标的业绩考核要求，2023年度冲回了股份支付成本。股份支付成本较2022年度减少463.29万元。</p> <p>Q13：在面对宏观经济波动和地缘政治冲突时，公司有哪些应对策略？</p> <p>答：1、开源节流；2、海外业务拓展；3、通过研发和产业投资，增加供应链稳定度。</p> <p>Q14：公司在未来五年的发展规中，有哪些具体的业务增长目标和策略？这些目标和策略的实施进展情况如何？</p> <p>答：公司未来五年的业务规划：1、规划积极投入AI数字机器人助理，AI边缘计算领域；2、继续增加传感器芯片、低功耗无线芯片、存储芯片等特色工艺、传统工艺产品在公司业务中的占比。</p> <p>Q15：目前在无线连接芯片销售额是多少？同比增长率是多少？</p> <p>答：2023年度数字通讯芯片及系统级应用产品的销售额44,745.62万元，同比增长20.10%。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年05月09日